

【裁判字號】102,行專訴,86

【裁判日期】1021219

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

102年度行專訴字第86號  
民國102年12月5日辯論終結

原 告 廖鈺達  
訴訟代理人 陳邦禮 專利師  
輔 佐 人 邱謙成  
被 告 經濟部智慧財產局  
代 表 人 王美花  
訴訟代理人 簡信裕  
參 加 人 美商佛姆費克托公司  
代 表 人 伊格爾·漢多斯  
訴訟代理人 楊祺雄 律師  
賴蘇民 律師  
蘇三榮 律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國102年5月28日經訴字第10206101940號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

#### 主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就發明第88384號「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體（瓷塊）」專利舉發案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

#### 事實及理由

##### 壹、事實概要：

參加人前於民國85年11月20日以「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體（瓷塊）」向被告申請發明專利，經被告編為第85114230號審查准予專利後，並於公告期滿後，發給發明第88384號專利證書（下稱系爭專利）。原告嗣以系爭專利違反核准時，即83年1月21日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第20條第1項第1款、第2項及第71條第3款等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。原處分審查期間，參加人於100年8月12日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告核認更正本應准予更正，並依更正本審認系爭專利無違前揭修正前專利法規定，以101年11月30日(101)智

專三（二）04069 字第10121355150 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部於102年5月28日經訴字第10206101940 號訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

- 一、原告認同被告對於所謂「探測插件組裝本身及空間變換器屬於系爭專利申請前之習知技術」認知，即系爭專利請求項1所界定「探測插件組裝本身及探測插件組上所配置之空間變換器」，為系爭專利申請人於其說明書及圖式中所自承之先前技術。系爭專利說明書及圖式未記載所謂「空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」，此描述有關空間變換器與被探測之電子組件之可測試區域大小關係。系爭專利僅記載「一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片的能力，其需要同大之空間變換器」。最多僅能解釋成空間變換器之尺寸與被探測之整個半導體晶片之尺寸一樣大，凡熟習此項技術者難以得知被告所述「空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」技術特徵，因文字未提及有關「電子組件之可測試區域」描述。
- 二、縱使系爭專利說明書有關「一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片的能力，其需要同大之空間變換器」描述，可支持系爭專利請求項1所記載「空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」技術特徵。惟系爭專利之說明書或圖式，未載明實施前述技術特徵之必要事項。綜觀系爭專利之說明書及圖式欲瞭解所謂「電子組件之可測試區域」定義時，原告從系爭專利說明書得「可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置」。而系爭專利整篇說明書無所謂「空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」描述。系爭專利之說明書或圖式未有實質揭露可測試區域與所對應之空間變換器之尺寸大小關係之相關描述，故熟悉此項技術者無法明確得知，系爭專利如何界定「相對較大基材」大小，或系爭專利如何界定「相對較大基材與多個模片位置」尺寸關係。再者，參酌系爭專利說明書之記載可知，其圖5B係顯示搭載有四組探測元件之單一空間變換器，可用於探測半導體晶片上之四個相鄰模片位置，亦可將晶片對著空間變換器放置二十五次之方式，用於探測具有一百個模片位置之半導體晶片。系爭專利反教示其空間變換器不與整個可測試區域有相同大小。因原告主張系爭專利請求項1有

違修正前專利法71條第3款之規定，且直接或間接附屬於系爭專利請求項1之附屬請求項2至14亦未載明實施「空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」必要技術特徵事項，足認請求項2至14有違修正前專利法第71條第3款之規定。

- 三、空間變換器屬於系爭專利申請人已承認之先前技術，空間變換器之結構特徵及功能，屬系爭專利申請前已為熟習該項技術者所知悉之先前技術。進一步探討系爭發明專利所欲解決之問題及其解決問題所採取之技術手段時，可發現系爭專利之發明目的，在提供具有彈簧接點之電子組件，譬如空間變換器基材與半導體裝置，而同時避免與直接在電子組件上製造彈簧接點有關聯之問題。而系爭專利為達成其發明目的所採取之技術手段，係依據本發明，探測元件，譬如彈簧接點，係被預先製造在個別彈簧接點載體上。此等瓷塊以其間界定關係，被裝載至另一個組件。參酌系爭專利說明書可知，系爭專利將具有彈性接點之載體配置於探測插件組裝之空間轉換器，以解決彈性接點元件直接接在電子組件上之缺點，有助於對電子組件進行修補。換言之，系爭專利解決自承先前技術在電子組件直接設置彈簧接點元件所衍生之問題，其技術手段在於將原本屬於自承先前技術之彈簧接點元件，不直接設置在屬於自承先前技術之空間變換器，而改成先將屬於自承先前技術之彈簧接點元件，設置在多數個瓷塊上後，再將設置有彈簧接點元件之多數個瓷塊，以類似貼磁磚之拼貼方式，設置在屬於自承先前技術之空間變換器基材，系爭專利即可達成在其說明書所描述之功效。進一步配合系爭專利圖4、圖5所揭露之部分元件(506、524)及圖7，當可瞭解何者為系爭專利申請人所揭露之自承先前技術、何者為系爭專利請求項1、15所請求之發明及兩者間之差異。其中系爭專利圖4所示之元件(400)即為屬於自承先前技術之空間變換器。而下方擷取自系爭專利圖5之元件，為空間變換器上直接設置回彈性接點結構之自承先前技術。圖7為系爭專利所請求項1、15所請求之發明，其中元件(706)為較大基材，元件(702)為接點載體，元件(710)為彈簧接點元件。
- 四、系爭專利更正後之請求項1、15據以請求專利之技術特徵，為利用瓷磚拼貼方式，間接在電子組件表面上設置探針之技術特徵，為系爭專利申請前，熟習該項技術者所習知之技術系爭專利請求項7進一步界定其彈簧接點元件為探測元件，而證據5之探針(3)屬於系爭專利所謂「彈簧接點元件」下位概念之探測元件。證據5之探針單元，係利用螺絲(6)鎖

固於探針卡基板(1)，致探針單元可視探測物之數量對應拆裝增減其數量。亦可拆裝更換任一個損壞之探針單元，而達成類似而僅更換磁磚而不用整面修復牆壁之功效，即達成系爭專利說明書所描述之功效，且由證據5之說明書內容可知，此功效為證據5之發明目的。系爭專利更正後請求項1、15據以請求專利之技術特徵，已見諸於證據5中。熟習該項技術者在遇見系爭專利所欲解決之問題時，即遇見直接在電子組件上設置彈簧接點元件所衍生之問題時，在參酌前述自承先前技術及證據5所揭露之內容後，可輕易將證據5所教示之利用次基板(2)間接將探針設置在探針卡基板之技術內容，組合應用於系爭專利申請人所揭露之自承先前技術之空間轉換器，而完成系爭專利更正後請求項1、15之發明，並達成系爭專利「避免與直接在電子組件上製造彈簧接點有關聯之問題」發明功效。系爭專利請求項1、15之發明，相較系爭專利申請人所揭露之自承先前技術與證據5之組合而言，屬於顯而易知且不具有無法預期之功效而不具進步性。

五、參酌系爭專利說明書之記載可知，僅須元件能達成改變節距之效果，為系爭專利所定義之空間變換器，即所謂「自一個節距至另一個節距造成互連之互連組裝，典型上係被稱為空間變換器」。而由上方所示之證據4第11圖可知，放置構件(954)之電路板(960)內部走線之節距(D1)，確實與構件之電性接點節距(D2)不同，故證據4之電路板實際上為系爭專利自承先前技術，或系爭專利說明書中所定義之空間變換器。證據4揭示之具有測試架構之晶片，相當於系爭專利請求項1、15中所定義之接點載體，而用以設置晶片之電路板相當於系爭專利之較大基材。由證據4記載可知，已教導利用多個小面積載體取代大面積之單一載體來進行組裝之概念。再者，對照上揭證據4之第11圖，該圖確實顯示其電路板上裝置有多個晶片，而熟習該項技術者均知，經由解焊製程即可將晶片自電路板上拆卸以便裝設新之晶片進行修復動作，而達成系爭專利使用瓷塊將探測元件間接裝設於較大基材之技術手段。換言之，系爭專利更正後請求項1、15據以請求專利之技術特徵，已見諸於證據4。證據4已揭露「系爭專利請求項1、15之接點載體放置於較大基材」技術特徵，故熟習該項技術者在參酌系爭專利自承先前技術及證據4所揭露的內容後，可輕易地將證據4所教示之利用構件間接將探測元件設置在電路板上之技術內容，組合應用於系爭專利申請人所揭露之自承先前技術之空間轉換器，而完成系爭專利更正後請求項1、15之發明。

- 六、證據7 為1993年3 月9 日公告之美國第5191708 號專利說明書，第4 圖揭露一種用以點測半導體晶圓(22)之檢測裝置，其探針(14)係設置於一多層佈線基板，而前述多層佈線基板則設置於一探針基板(28)。多層佈線基板與探針基板之頂面接點與底面接點之節距不同，故多層佈線基板與該探針基板本身即為空間變換器，由此可說明系爭專利所述之空間變換器，確實屬於系爭專利申請前之先前技術，為熟習探針卡技術領域者所習知。參照證據7 第3 圖及其說明書記載可知，搭載有探針之基板(40)可限制所需面積至多針形成區域，使得基板之面積小於多層佈線基板(43)之面積。而系爭專利請求項2 附屬於請求項1，並進一步定義其特徵在於電子組件為半導體晶片。請求項3 之特徵在於可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置，彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸。請求項4 之特徵在於電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半。請求項7 之特徵在於彈簧接點元件為探測元件，此特徵已揭露於證據7。系爭專利請求項8 進一步定義其特徵在於彈簧接點元件為複合互連元件。證據7 說明書已說明其探針元件可為表面披覆不同金屬之複合互連元件，故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項8 不具進步性。
- 七、請求項9 之特徵在於焊料係連接在瓷塊基材與大基材間，由上方重製之證據7 第3 圖可知，焊料(44)連接在面積較小之基板與面積較大之多層佈線基板間。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項9 不具進步性。請求項10之特徵在於電子組件為半導體晶片，各瓷塊基材之彈簧接點元件，以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。證據7 之元件為半導體晶片，而其探針以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項10不具進步性。請求項11之特徵在於電子組件為半導體晶片，各瓷塊基材之彈簧接點元件係接觸半導體晶片上之至少兩個半導體模片。證據7 之元件為半導體晶片，而證據7 之探針可接觸半導體晶片上之至少兩個半導體模片。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項11不具進步性。
- 八、請求項12之特徵在於瓷塊基材係藉焊料接頭而與大基材對準

，由上方重製之證據7 第3 圖可知，焊料連接在面積較小之基板與面積較大之多層佈線基板間，藉此較小之基板可藉由焊料與面積較大之多層佈線基板對準。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項12不具進步性。請求項13之特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件。證據7 裝載有探針之基材可裝載至面積較大之基材或基材，而面積較大之基材或係被裝載至探針基板(28)。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或者證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項13不具進步性。請求項14之特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件，並藉插入物連接至探測插件。證據7裝載有探針之基材可裝載至面積較大之基材或基材，而面積較大之基材係被裝載藉由探針基板而被裝載至基板(27)。故證據7 加上自承先前技術與證據5 之組合，或者證據7 加上自承先前技術與證據4 之組合，足以證明請求項13不具進步性。

- 九、依據公知技術、自承先前技術與證據5 之組合或者公知技術、自承先前技術與證據4 之組合足以證明系爭專利請求項5 至6 不具進步性。系爭專利請求項5 、6 附屬於請求項1，且界定電子組件係為印刷電路板或液晶顯示器。由於凡熟習該項技術領域者皆知，一般待測物可為印刷電路板、液晶顯示器或者半導體晶圓等電子組件，故此電子組件為印刷電路板或液晶顯示器實屬熟習該項技術者眾所周知之公知技術。原告主張依據前述公知技術、自承先前技術與證據5 之組合或者依據前述公知技術、自承先前技術與證據4 之組合，請求項5 、6 分別不具有進步性。再者，自承先前技術與證據5 之組合或者自承先前技術、證據4 與證據5 之組合足以證明系爭專利請求項16至18不具進步性。請求項16之特徵在於探測元件為自由站立彈簧接點。證據5 第2 圖之探針(3) 係自次基板(2) 自由延伸站立並具有一定彈性，故請求項16之技術特徵已見於證據5 。請求項17進一步界定尖端結構係經裝載至多個自由站立彈簧接點。如證據5 第2 圖所示，其探針3 具有一尖端結構，故請求項16之技術特徵已見於證據5 。請求項18之特徵在於自由站立彈簧接點為複合互連元件。故依自承先前技術與證據5 之組合。或依據自承先前技術、證據4 與證據5 之組合，請求項16至18分別不具有進步性。
- 十、參加人於審理程序中已自認，系爭專利圖4 、圖5 及圖5B係習知技術，且為熟悉該項技術者所清楚了解，故參加人應受

禁反言原則之規範。證據8 作為輔助說明系爭專利圖4、5 及圖5B，確實為系爭專利自承先前技術之關聯證據。其公開日期為1996年5月23日，早於系爭專利之申請日，故證據8 有證據能力。證據8 同為參加人所申請，故證據8 所揭露之技術內容在參加人申請系爭專利前，參加人應知之甚詳。參加人在系爭專利申請前，已知悉系爭專利之圖4、圖5 及圖5B，屬系爭專利申請日前已公開見於刊物之先前技術。申言之，系爭專利圖4、5 及圖5B屬於系爭專利之自承先前技術，故參加人有關係爭專利圖4、圖5 及圖5B並非系爭專利之自承先前技術主張，實不足採。依系爭專利自承先前技術與證據5 之組合，或系爭專利自承先前技術、證據5 與證據7 或公知技術之組合，足以證明系爭專利所有請求項1 至18不具進步性。依據證據8 與證據5 之組合，或證據8、證據5 與證據7 或公知技術之組合，足以證明系爭專利所有請求項1 至18不具進步性。系爭專利請求項1 至14違反修正前專利法第71條第3 款之規定。依系爭專利自承先前技術與證據4 之組合，或系爭專利自承先前技術、證據4 與證據7 或公知技術之組合足以證明系爭專利請求項1 至15不具進步性。準此，起訴聲明請求原處分及原決定均撤銷，暨命被告對第88384 號發明專利應為舉發成立之處分。

參、被告答辯：

- 一、系爭專利請求項1 「探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」，定義空間變換器與被探測之電子組件之可測試區域之大小關係，其於系爭專利說明書記載「一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片的能力，其需要同大之空間變換器」，熟習該項技術者在參酌說明書及申請專利範圍之記載應可瞭解其內容。就待探測之電子組件而言，其可位於晶圓上之模片，故熟習該項技術者基於系爭專利所揭示內容配合其對於空間變換器、待測電子元件，即可瞭解其內容並據以實施。再者，系爭專利說明書已揭示「較大基材一詞係為可於其表面上裝載多個瓷塊之任何基材」，可知載體基板之個數可配合較大基材面積作任意選擇，系爭專利說明書雖僅例示具有4 個或3 個載體基板，其未揭示2 個載體基板，惟2 個或以上之載體基板應屬系爭專利之範圍。故系爭專利請求項1 至14未違反修正前專利法第71條第3款之規定。
- 二、系爭專利自承先前技術揭示一種探測電子組件之方法，此方法包含使電子組件(508) 與多個彈簧接點元件(524) 接觸，提供相對較大基材(506)，其為探測插件組裝(500) 空間變

換器，係期望被探測之電子組件之可測試區域相同大小，大基材具有前方表面。多個彈簧接點元件自其表面延伸，促使該大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸。系爭專利自承先前技術揭示一種探測插件組裝，其包括一個空間變換器基材，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端(522) 經配置在頂部表面及第二組多個末端(520) 經配置在底部表面，多個探測元件經配置在空間變換器基材之頂部表面。系爭專利之先前技術揭示空間變換器及將彈簧接點元件直接連接在空間轉換器上之技術，系爭專利為解決該習知之彈性接點元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題，提出裝載及連接至少兩個之多個接點載體至大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸之技術手段。藉由將多個彈簧接點元件連接至接點載體後，將接點載體連接置空間轉換器而達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個接點載體及可不須對整個電子組件進行修復。

三、證據5 揭示一種探針卡，其圖1 中揭示於探針卡基板上裝設有8 個探針卡次基板，每個探針卡基板上裝設有多數個探針，藉此於探針卡基板上形成四組相對之IC1 至IC4 用之探針卡次基板，證據5 之探針單元，利用螺絲鎖固於探針卡基板上，致探針單元可視探測物之數量對應拆裝增減其數量，亦可拆裝更換任一個損壞之探針單元，達成易於維修探針單元之功效。熟習該項技術者在參酌系爭專利自承之先前技術，為解決習知之彈性接點元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題，有動機採用證據5 所教示將探針元件先裝載於次基板上，再將次基板裝載至主基板之方法，用以解決維修不易之問題，故系爭專利請求項1 、15為發明所屬技術領域中具通常知識者依系爭專利所自承之先前技術及證據5 之組合所能輕易完成，故系爭專利自承之先前技術與證據5 之組合足以證明系爭專利請求項1 、15不具進步性。

四、請求項2 依附於請求項1 之附屬項，其進一步限縮電子組件為半導體晶片，請求項3 依附於請求項2 之附屬項，其限定可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置，彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸，請求項4 依附於請求項1 ，其進一步界定電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半，請求項7 依附於請求項1 之附屬項，其進一步限縮彈簧接點元件為探測元件，技術特徵見於證據7 之第4 圖或申請人自承之先前技術中，故該請求項為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術



、證據5 及證據7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據5 及證據7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項2 至4 、7 不具進步性。請求項8 依附於請求項1 之附屬項，其進一步限縮彈簧接點元件為複合互連元件。證據7 說明書揭示探針元件(14)可為表面披覆不同金屬之複合互連元件，請求項8 為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據5 及證據7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據5 及證據7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項8 不具進步性。

五、請求項9 、12依附於請求項1 之附屬項，其進一步限縮焊料係連接在瓷塊基板與大基材間。證據5 雖揭示利用螺絲鎖固次基板與主機板、系爭專利利用焊料進行黏著不同，惟利用焊料來作為大小基板之黏固已見於證據7 之第3 圖，請求項9 、12為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據5 及證據7 之組合所能輕易完成。故系爭專利自承先前技術與證據5 及證據7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項9 、12不具進步性。請求項10、11依附於請求項1 之附屬項，其進一步限縮電子組件為半導體晶片，各瓷塊基材之彈簧接點元件，係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模組。證據7 第4 圖揭示探針係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。請求項10、11為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據5 及證據7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據5 及證據7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項10、11不具進步性。

六、請求項13、14依附於請求項1 ，其進一步界定具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件，並藉由插入物連接至探測插件，大基材裝載至探測插件為系爭專利自承先前技術，或見於證據7 第4 圖，請求項13、14為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據5 及證據7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據5 及證據7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項13、14不具進步性。依系爭專利自承先前技術與公知技術及證據5 之組合，可證明系爭專利更正後請求項5 、6 違反核准審定時專利法第20條第2 項之進步性要件。請求項5 、6 依附於請求項1 之附屬項，其限縮電子組件為印刷電路板或液晶顯示板，其為申請前之公知技術。因系爭專利自承先前技術與證據5 之組合可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，故系爭專利自承先前技術與公知技術及證據5 之

組合可證明系爭專利更正後請求項5、6不具進步性。請求項16依附於請求項15之附屬項，其進一步限縮探針元件為自由站立彈簧接點，請求項17依附於請求項16其進一步界定尖端結構係經由裝載至多個自由站立彈簧接點，請求項18依附於請求項16，其界定自由站立彈簧接點為複合互連元件。該技術特徵已見於系爭專利自承先前技術，因系爭專利自承先前技術與證據5之組合可證明系爭專利更正後請求項15不具進步性，故系爭專利自承先前技術與證據5之組合，可證明系爭專利更正後請求項16至18不具進步性。因系爭專利自承先前技術與證據5之組合，可證明系爭專利更正後請求項16至18不具進步性，故系爭專利自承先前技術與證據5及證據4之組合，可證明系爭專利更正後請求項16至18不具進步性。

七、證據4 揭示一種單晶片IC測試器結構，其中第10圖揭示一個轉接器(950)其上具有待測試裝置(952)，其下則連接一具有增進測試結構之晶片(954)，圖11揭示晶片係放置於PCB板，證據4 揭示之構件為一晶片結構，其與系爭專利請求項1之接點載體並非相同構件。再者，證據4 揭示放置於PCB板上，其與系爭專利請求項1之接點載體放置於探測插件組裝之空間轉換器兩者之構件不同，空間轉換器雖為系爭專利申請前已知悉之先前技術，惟證據4 揭示晶片放置於PCB板上與系爭專利接點載體放置於探測插件組裝之空間轉換器兩者，並非對應相同之構件，且證據4 未教示與系爭專利自承之先前技術兩者間之組合動機，故由系爭專利自承先前技術與證據4之組合，尚難證明系爭專利更正後請求項1、15違反核准審定時專利法第20條第2項之進步性要件。證據7 揭示關於一種探針頭之製造方法。其中第1A到1G與2A到2E圖中揭示利用光罩等技術，在基板上直接形成具有尖端之垂直探針元件。證據7 之探針元件，其與系爭專利之彈簧接點元件不同。證據7 之構件(40)為一具穿孔之基板，其與系爭專利請求項2至4、7至14所依附之獨立項1、15之接點載體並非相同構件。再者，證據7 雖揭示該基板可裝載至基材(43)，惟基材為一多層之佈線基板，其與系爭專利請求項2至4、7至14所依附之獨立項1、15之接點載體，放置於探測插件組裝之空間轉換器，兩者構件不同，且證據4、7 未教示與系爭專利自承之先前技術間之組合動機，故由系爭專利自承先前技術與證據4及7之組合，尚難證明系爭專利更正後請求項2至4、7至14違反核准審定時專利法第20條第2項之進步性要件。準此，被告所為原處分並無違法，聲明請求

駁回原告之訴。

肆、參加人答辯：

- 一、系爭專利說明書明確記載圖4、圖5及圖5B為系爭專利實施例之相關圖面，並非為先前技術之圖面，原告稱系爭專利之圖4、圖5及圖5B為系爭專利之自承先前技術，顯有違誤。再者，系爭專利為美國專利申請案08 / 554,902 之部分連續案可知，系爭專利之圖4、圖5及圖5B引自其美國相應案之母案。前揭美國專利申請案之公開日期為1999年11月2日，晚於系爭專利之申請日1996年11月20日，不具備先前技術之適格。是系爭專利說明書未記載圖4、圖5及圖5B為系爭專利之先前技術，且圖5、圖5B係引自公開日較晚之美國專利申請案，故系爭專利之圖4、圖5及圖5B非系爭專利之自承先前技術，原告於本件訴訟中將不具證據能力之圖4、圖5及圖5B與舉發證據4、證據5、證據7組合，不具證據適格性。
- 二、證據5所揭示之探針(3)雖用以造成與電子組件末端之互連元件，惟未如系爭專利彈簧接點元件具有彈性。且證據5之探針卡基板(1)未具有系爭專利之空間變換器結構，而系爭專利之圖4、圖5及圖5B未教示可將探針裝載至接點載體，再將多個接點載體連接至空間變換器上之方法。再者，證據5與系爭專利之圖4、圖5及圖5B均未揭露系爭專利「其為探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」，故可一次接觸測試整個待測試區域之技術特徵。是技藝人士並無動機將兩不相容之結構組合，而達到系爭專利解決探測插件組件各種問題，包括空間變換器基材本身是較昂貴基材，所安裝之彈簧探測元件製造上有產率之問題，而影響製得空間變換器之成功率，待測晶片之不同時空間變換器，其因應變換在探測上之問題，而揭示解決方案，即針對於具有與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大之空間變換器，將至少兩個具有多個彈簧接點元件自其表面延伸之載體，裝載並連接至空間變換器之表面。即使空間變換器為配合待測晶圓測定面積很大，系爭專利利用多個其表面有彈簧接點元件延伸之載體／瓷塊，利用類似瓷磚拼貼之概念，而將其電連到空間變換器之表面。即使存在有上述彈簧接點元件有產率之問題，系爭專利可將有問題之載體／瓷磚直接更換，即可達成使用大空間變換器之面積測定晶圓，而無習知製造困難與成本過高之問題。系爭專利所揭示之方法與探針插件組裝等，不論在所欲解決之問題，乃至於解決問題之技術概念與手段，均為系爭專利之圖4、圖5及

圖5B與證據5 未曾揭示或教示者，故具備進步性。

三、證據4 揭示一種單晶片IC測試器結構，其中圖10揭示一個轉接器其上具有待測試裝置，其下則連接一具有之增進測試結構之晶片，圖11揭示晶片放置於PCB 板上，證據4 揭示之構件為一晶片結構，其與系爭專利請求項1、15之接點載體並非相同構件。再者，證據4 揭示構件晶片放置於PCB 板上，其與系爭專利請求項1、15之接點載體，放置於探測插件組裝之空間轉換器兩者之構件不同。且系爭專利之圖4、圖5及圖5B之空間變換器，係用於裝載接點載體以連接彈簧接點元件，非用以裝載晶片，故縱將系爭專利之圖4、圖5及圖5B之空間變換器與證據4 之晶片加以組合，亦無法達到系爭專利「使電子組件與多個彈簧接點元件接觸」以測試電子元件之技術特徵，無法證明系爭專利請求項1、15不具進步性。系爭專利請求項5、6 依附於獨立項1，而系爭專利之圖4、5、5B與證據5 之組合，或系爭專利之圖4、圖5及圖5B及證據4 之組合，均無法證明系爭專利獨立項1 不具進步性。該等證據組合亦無法證明附屬項5、附屬項6 不具進步性。系爭專利請求項16至18直接或間接依附於獨立項15，而系爭專利之圖4、圖5及圖5B與證據5 之組合，或系爭專利之圖4、5、5B及證據4 之組合，均無法證明系爭專利獨立項15不具進步性。則該等證據組合亦無法證明附屬項16至18不具進步性。

四、證據7 所揭示之探針未如系爭專利彈簧接點元件具有彈性，且證據7 之構件為一具穿孔之基板，無法達到更換之功能，故與系爭專利請求項1、請求項15之接點載體並非相同構件。再者，證據7 雖揭示基板可裝載至基材，惟基材為一多層之佈線基板，其與系爭專利請求項1、15之接點載體，放置於探測插件組裝之空間轉換器兩者之構件不同。是證據7 與證據5、系爭專利之圖4、圖5及圖5B相同，均未揭示可將探針3 裝載至接點載體，再將多個接點載體連接至空間變換器上之方法。無法證明獨立項1、請求項15不具進步性，自亦無法證明附屬項2 至附屬項4、附屬項7 至14不具進步性。請求項1 「探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」，其定義空間變換器與被探測之電子組件之可測試區域面積相同，故系爭專利說明書記載「一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片之能力，其需要同大之空間變換器」，熟習該項技術者在參酌說明書及申請專利範圍之記載即可瞭解，未違反系爭專利審定時專利法71條第3 款應記載實施之必要事項之規定。

五、證據8 至多僅得視為新引證資料，其所揭露之內容與系爭專利是否自承之先前技術，係屬二事。是未將證據8 與系爭專利申請專利範圍之要件進行比對，且未具體指出證據8 究係於何一段落揭示系爭專利之何要件。縱證據8 已揭露系爭專利之圖4、圖5 及圖5B，然證據8 與證據5 之組合，未揭露系爭專利請求項1、15之全部要件。再者，證據8 所揭露者，即為「將彈性接點元件直接接在電子元件上」結構，此為原告所自承。是證據5 未教示如系爭專利所揭示之「將具有彈性接點之載體配置於探測插件組裝之空間變換器上，以解決彈性接點元件直接接在電子元件上的缺點」，技藝人士並無動機將兩不相容之結構組合，而達到系爭專利解決探測插件組件各種問題，故系爭專利所揭示之方法與探針插件組裝，無論是在所欲解決之問題，乃至於解決問題之技術概念與手段，均為證據8 與證據5 未曾揭示或教示者，故具備進步性。且訴願機關及被告於訴願階段已清楚闡釋證據8 與證據7 未曾揭示或教示系爭專利之上述技術特徵，技藝人士並無動機將兩不相容之結構組合，故系爭專利應具備進步性。準此，聲明請求駁回原告之訴。

伍、本院判斷：

一、原處分與原決定：

參加人前於85年11月20日以「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體（瓷塊）」向被告申請發明專利，經被告編為第85114230號審查准予專利後，並於公告期滿後，發給發明第88384 號專利證書。原告嗣以系爭專利違反核准時，即修正前專利法第20條第1 項第1 款、第2 項、及第71條第3 款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。原處分審查期間，參加人於100 年8 月12日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告核認該更正本應准予更正，並依該更正本審認系爭專利無違前揭修正前專利法規定，以101 年11月30日(101)智專三（二）04069 字第10121355150 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部訴願審議委員會以相同理由，駁回原告之訴願（見本院卷第81頁至第91頁）。原告不服訴願決定，向本院提起行政訴訟。

二、本件專利舉發爭點：

(一)本件應適用83年1月21日修正公布之專利法：

按利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依法申請取得發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用者；或運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，則不得依法申請取得發明

專利。說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權。修正前專利法第20條第1項第1款、第2項及第71條第3款分別定有明文。查系爭專利之申請日為85年11月20日，核准公告日為86年8月11日，故本件關於系爭專利是否符合充分揭露原則，暨有無具備新穎性、進步性之判斷，應依核准審定時有效之83年1月21日修正公布之專利法為斷。

(二)本院審理本件之範圍：

按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。智慧財產案件審理法第33條定有明文。原處分認系爭專利未違反修正前專利法第20條第1項第1款及第2項及第71條第3款之規定，而原告於本件審理中對於系爭專利未違反修正前專利法第20條第1項之新穎性部分，並未爭執，僅爭執系爭專利違反修正前專利法第20條第2項及第71條第3款規定之部分（見本院卷第151頁）。參諸原告主張系爭專利不具進步性之爭點，其證據組合及理由與原舉發階段所主張之爭點不同，其為行政訴訟階段提出證據1至8與先前技術之組合，核屬為新證據組合及舉發理由，並經被告與參加人就該等新證據與理由提出答辯書狀及陳述，表明原告關於該等證據之主張有無理由。揆諸前揭說明，本院應就原告於行政訴訟階段提出之證據組合及理由，判斷系爭專利是否有違反修正前專利法第71條第3款之可實施性、專利法第20條第2項之進步性。準此，首應分別說明系爭專利及引證技術內容，作為認定系爭專利是否違反修正前專利法第71條第3款、第20條第2項之基礎，進而分析與比對系爭專利及引證技術特徵，最後判斷系爭專利有無應撤銷之事由。

三、系爭專利技術之分析：

(一)系爭專利技術說明：

系爭專利為多個接點元件，其接點硬塊或自由站立彈簧接點，包括單塊與複合之互連元件，將其裝載至相對較小瓷塊基材，接著將其裝載及連接至相對較大電子組件基材，藉以殖入具有多個接點元件之電子組件，同時避免直接在電子組件上產生接點元件之必要性。相對較大電子組件係適當為探測插件組裝之空間變換器組件。此方式可對整個半導體晶片造成壓力接頭，同時提供晶片級燒入。焊料球、z-軸導電性黏

著劑或柔順性接頭，可適當用以製造瓷塊基材與電子組件間之電接頭。半導體晶片之多個模片位置，易於使用所揭示之技術探測，且瓷塊可經排列以使整個晶片之探測達最佳化。

(二)系爭專利請求項內容分析：

依101年12月11日更正公告，系爭專利請求項共18項，其中第1及15項為獨立項，其餘請求項為依附於第1或15項之附屬項，系爭專利相關圖式如本判決附圖1所示，茲依據其獨立項與附屬項關係，說明系爭專利請求項內容如後：

1.獨立請求項1與其附屬請求項1至14之內容：

(1)請求項1之內容：

一種探測電子組件之方法，此方法包含使電子組件與多個彈簧接點元件接觸，其特徵在於提供相對較大基材，其為探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，大基材具有前方表面；裝載及連接至少兩個之多個接點載體至該大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸；促使大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸。

(2)請求項1至14之內容：

請求項2 依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片。請求項3 依據請求項2 之方法，其特徵在於可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置；彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸。請求項4 依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半。請求項5 依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為印刷電路板。請求項6 依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為液晶顯示板。請求項7 依據請求項1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為探測元件。請求項8 依據請求項1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為複合互連元件。請求項9 依據請求項1 之方法，其特徵在於焊料係連接在瓷塊基材與大基材之間。請求項10依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件，係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。請求項11依據請求項1之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件係接觸半導體晶片上之至少兩個半導體模片。請求項12依據請求項1之方法，其特徵在於瓷塊基材係藉焊料接頭而與大基材對準。請求項13依據請求項1 之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件。請求項14依據請求項1之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係

被裝載至探測插件，並藉插入物連接至探測插件。

## 2.獨立請求項15與其附屬請求項16至18之內容：

### (1)請求項15之內容：

一種探測插件組裝，其包括一個探測插件及多個探測元件，其特徵在於一個空間變換器基材，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端經配置在頂部表面上及第二組多個末端經配置在底部表面上；至少兩個瓷塊基材，各具有頂部表面、底部表面；用以在瓷塊基材與空間變換器基材之間達成電連接之裝置；多個探測元件經配置在瓷塊基材之頂部表面上。

### (2)請求項16至18之內容：

請求項16依據請求項15之探測插件組裝，其特徵在於探測元件為自由站立彈簧接點。請求項17依據請求項16之探測插件組裝，其特徵在於尖端結構係經裝載至多個自由站立彈簧接點之末端。請求項18依據請求項16之探測插件組裝，其特徵在於自由站立彈簧接點為複合互連元件。

## 四、引證技術分析：

### (一)證據1之技術內容：

證據1 為1995年12月19日公告之美國US0000000 號「METHOD OF MANUFACTURING ELECTRICAL CONTACTS,USING ASACRIFICIAL MEMBER」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術。

### (二)證據2之技術內容：

證據2 為1974年4月23日公告之美國US0000000 號「PROBE CONTACTOR HAVING BUCKLING BEAM PROBES」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術。

### (三)證據3之技術內容：

證據3 為1995年3月7日公告之美國US0000000 號「MEMBRANE CONNECTOR WITH STRETCH INDUCED MICRO SCRUB」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術。

### (四)證據4之技術內容：

證據4 為1995年3月7日公告之美國US0000000 號「SINGLE CHIP IC TESTER ARCHITECTURE」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術，其圖式如本判決附圖2所示。揭示一種單晶片IC測試器結構(single chip IC tester architecture)，證據4第10圖係揭示待測試裝置(952)置於轉接器(950)，而轉接器(adapter/-socket)下則連接一具有增進測試結構之晶片(954)；證據4圖11揭示



具有增進測試結構之晶片係置於PCB 板。

(五)證據5之技術內容：

證據5為1994年12月22日公開之日本特開平0-000000號專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術，其圖式如本決附圖3 所示。證據5 圖1 揭示一種探針卡，其於探針卡基板(1) 上裝設有8 個探針卡次基板(2) ，每個探針卡基板上裝設有複數個探針(3) ，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供IC1 至IC4 用之探針卡次基板(10~ 13)，而探針卡次基板，係利用螺絲(6) 鎖固於探針卡基板上，以致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞之探針卡次基板，而達成易於維修探針卡之功效。

(六)證據6之技術內容：

證據6 為1996年5 月7 日公告之美國US0000000 號「METHOD FOR MANUFACTURING A PROBE」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術。

(七)證據7之技術內容：

證據7 為1993年3 月9 日公告之美國US0000000 號「MANUFACTURING METHOD OF A PROBE HEAD FOR SEMICONDUCTOR L-SI INSPECTION APPARATUS」專利，其公告日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術，其圖式如本決附圖4 所示。證據7 第4 圖揭示檢側半導體晶圓(22)之檢測裝置及方法，其所欲檢測之電子組件即為半導體晶片。

(八)證據8之技術內容：

證據8 為1996年5 月23日公開之第WO 96/15458 號「PROBE CARD ASSEMBLY AND KIT,AND METHODS OF USING SAME 」專利，其公開日早於系爭專利申請日1996年11月20日，可為先前技術。

五、技術爭點分析：

本院整理當事人之主要技術爭點有五：（一）系爭專利請求項1 至14是否違反核准審定時之專利法第71條第3 款之規定。（二）證據8 與5 之組合，是否足以證明系爭專利請求項1 、15違反核准審定時專利法第20條第2 項之進步性要件。

（三）證據8 、5 及7 之組合，是否足以證明系爭專利請求項2 至4 、7 至14違反核准審定時專利法第20條第2項之進步性要件。（四）證據8 、5 及7 之組合，是否足以證明系爭專利請求項2 至4 、7 至14違反核准審定時專利法第20條第2 項之進步性要件。（五）證據8 及證據5 之組合，是否足以證明系爭專利請求項16至18違反核准審定時專利法第20

條第2 項之進步性要件（見本院卷第227 至229 、234 至237 頁）。職是，本院依序探討如後：

(一)系爭專利請求項1 至14符合修正前專利法第71條第3款：

1.本件應適用83年1月21日修正公布之專利法：

系爭專利「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體（瓷塊）」申請日為85年11月20日，被告於86年7 月15日審定准予專利，其是否有應不予專利之情事，自應以83年1 月21日修正公布之專利法規定為斷。而83年1 月21日修正公布之專利法第71條第3 款規定，說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢。

2.系爭專利請求項1符合修正前專利法第71條第3款：

原告雖主張系爭專利請求項1 所載之技術特徵為提供相對較大基材，其為探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，未完整揭露於申請時說明書或圖式之記載中云云。惟查

(1)較大基材為可於其表面上裝載多個瓷塊之任何基材：

系爭專利說明書第12頁第4 段記載於本文中使用的較大基材一詞，係為可於其表面上裝載多個瓷塊之任何基材。此特別包括探測插件組裝之空間變換器，可知較大基材即指探測插件組裝之空間變換器。由系爭專利說明書第18頁末段至第19 頁首段記載關於本發明之一項特別有用之應用，係為提供一種探測具有多個彈簧接點元件之電子組件之可測試區域之方法，其方式是殖入多個接點載體至較大基材，並促使該大基材及電子組件朝向彼此，以致使自瓷塊基材之表面延伸之彈簧接點元件，造成與電子組件可測試區域上之相應末端接觸。此電子組件可為半導體晶片，此可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置。

(2)揭示探測具有多個彈簧接點元件之電子組件之可測試區域：

系爭專利說明書第56頁倒數第2 行至第57頁第1 行記載一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片之能力，其需要同大之空間變換器可知，系爭專利揭示欲探測具有多個彈簧接點元件之電子組件之可測試區域，較大基材上之彈簧接點元件需與該電子組件可測試區域上之相應末端互相接觸，因較大基材之面積需與電子組件可測試區域一樣大，使可達成前述互相接觸，令其具有在單程中測試整個半導體晶片之能力。職是，系爭專利說明書相關段落揭示系爭專利請求項1 「提供相對較大基材，其為探測插件組裝之空間變換器係與期望

被探測之電子組件之可測試區域一樣大」技術特徵，並未違反核准審定時專利法第71條第3款之規定。

3. 系爭專利請求項2至14符合修正前專利法第71條第3款：

系爭專利請求項1 未違反核准審定時專利法第71條第3款之規定，已如前述，故直接或間接依附於請求項1 之附屬項2至14，自無違反核准審定時專利法第71條第3款之規定之情事，原告主張不可採。至於原告固主張系爭專利圖5B及第55頁第二段所記載係反向教示空間變換器並不與整個可測試區域同大云云。然系爭專利圖5B及第55頁第二段所載僅為系爭專利所舉之一特殊實施例，其係為另一種不同之發明態樣，並非系爭專利請求項1 至14之發明，益徵原告主張不可採。

(二) 組合證據8與5可證明系爭專利請求項1、15不具進步性：

1. 組合證據8與5可證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1) 證據8 揭示系爭專利請求項1之技術特徵：

證據8 之圖4、5、5B揭示一種探測半導體晶片(508)之方法，此方法包含使半導體晶片與多個回彈式互連元件(524)接觸，提供已適當形成電路之基材(518)，其為探測插件組裝(500)空間變換器(506)，基材具有前方表面；多個回彈式互連元件自其表面延伸，促使基材與半導體晶片朝向彼此，致使回彈式互連元件造成與半導體晶片接觸；其中證據8所揭之半導體晶片、回彈式互連元件及已適當形成電路之基材，係分別可對應至系爭專利請求項1「電子組件」、「彈簧接點元件」及「相對較大基材」。故證據8 揭示系爭專利請求項1「一種探測電子組件(508)方法，此方法包含使電子組件與多個彈簧接點元件(524)接觸，其特徵在於提供相對較大基材(518)，其為探測插件組裝(500)空間變換器(506)係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，大基材具有前方表面；多個彈簧接點元件自其表面延伸，促使大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸」技術特徵。比對證據8 與系爭專利請求項1 之技術特徵，如本判決附表所示。

(2) 證據5揭示系爭專利請求項1之技術特徵：

系爭專利請求項1 與證據8 之差異，雖在於系爭專利係裝載及連接至少兩個之多個接點載體至該大基材之前方表面，而各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸；藉由前述技術手段，可達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個接點載體，而不須對整個電子組件進行修復，此可解決先前技術之彈性接點元件直接接在電子組件間變換器上而造成維修不易之問題。惟證據5 圖1 揭示一種探針卡

，其於探針卡基板(1) 上裝設有8 個探針卡次基板(2) ，每個探針卡基板上裝設有複數個探針(3) ，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供IC1 至IC4 用之探針卡次基板(10~13) ，而探針卡次基板係利用螺絲(6) 鎖固於探針卡基板上，致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞的探針卡次基板，而達成易於維修探針卡的功效。證據5 所揭之探針卡基板、探針卡次基板及探針，係分別可對應至系爭專利請求項1 「大基材」、「接點載體」及「彈簧接點元件」。故證據5 揭示系爭專利請求項1 「裝載及連接至少兩個之多個接點載體至大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸」技術特徵，比對證據5 與系爭專利請求項1 之技術，如本判決附表所示。

(3)所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成：

證據8 及證據5 均屬探測電子組件之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，其面臨如何改良探測電子組件之相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容，並予以應用或組合，其組合係屬明顯。準此，系爭專利請求項1 為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 及證據5 所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

2. 組合證據8與5可證明系爭專利請求項15不具進步性：

(1)證據8 揭示系爭專利請求項15之技術特徵：

證據8 揭示系爭專利請求項15之一種探測插件組裝(500) ，其包括一個空間變換器基材(518) ，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端(522) 經配置在頂部表面及第二組多個末端(520) 經配置在底部表面，多個探測元件(524) 經配置在空間變換器基材之頂部表面等技術特徵。

(2)證據5揭示系爭專利請求項15之技術特徵：

系爭專利請求項15與證據8 之差異，雖在於系爭專利裝載及連接至少兩個瓷塊基材至空間變換器基材，瓷塊基材與空間變換器基材之間達成電連接及多個探測元件經配置在瓷塊基材之頂部表面；藉由前述技術手段，可達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個瓷塊基材，而不須對整個電子組件進行修復，此可解決先前技術之探測元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題。惟證據5 圖1揭示一種探針卡，其於探針卡基板(1) 上裝設有8 個探針卡次基板(2) ，每個探針卡基板上裝設有複數個探針(3) ，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供IC1 至IC4 用之探針卡次基板(10~13) ，而探針卡次基板係利用螺絲(6)鎖固於探

針卡基板，致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞之探針卡次基板，而達成易於維修探針卡之功效。其中證據5所揭之探針卡基板、探針卡次基板及探針分別可對應至系爭專利請求項15「空間變換器基材」、「瓷塊基材」及「探測元件」。故證據5 揭示系爭專利請求項15之至少兩個瓷塊基材，各具有頂部表面、底部表面；用以在瓷塊基材與空間變換器基材間達成連接之裝置；多個探測元件經配置在瓷塊基材次基板之頂部表面上等技術特徵。

(3)所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成：

證據8 及證據5 均屬探測電子組件之技術領域，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當面臨如何改良探測電子組件之相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合，其組合係屬明顯。準此，系爭專利請求項15 為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 及證據5 所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

(三)組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項2至4、7至14不具進步性：

1. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項2不具進步性：

證據8 及證據5 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項2 之內容，為依附於請求項1 之附屬項，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片。證據7 之第4 圖揭示檢側半導體晶圓(22)之檢測裝置及方法，其所欲檢測之電子組件即為半導體晶片。另證據8 之圖4、5、5B揭示一種探測半導體晶片(508) 方法，其所欲檢測之電子組件即為半導體晶片，故系爭專利請求項2 所附加之技術特徵揭示於證據7 或證據8。準此，組合證據8、5 及7，足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

2. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項3不具進步性：

證據8、證據5 及證據7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，系爭專利請求項3 依附於請求項2，其內容為依據請求項2 之方法，其特徵在於可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置；彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸。證據7 之第4 圖所揭示元件(22a) 所在之位置可對應至系爭專利之模片位置，而證據7 之第4 圖之探針元件(14) 可同時與多個元件接觸，故證據7 揭示該可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置；接點元件係同時造成與多個模片位置接觸等技術特徵。準此，系爭專利請求項3 為所屬技術領域具通常知識者，依證據8、5 及7 所揭之技術內容所

能輕易完成，足證系爭專利請求項3 不具進步性。

3. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項4不具進步性：

證據8 及證據5 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項4 依附於請求項1 ，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半。證據7 之第4 圖揭示多個元件(22a) 所在之位置，佔據整個半導體晶圓(22)整體表面積之至少一半，故系爭專利請求項4 所附加之技術特徵揭示於證據7 。準此，證據8 、證據5 及證據7 之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

4. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項7不具進步性：

證據8 及證據5 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項7 依附於請求項1 ，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為探測元件。證據8 之圖4 、5 、5B揭示回彈式互連元件524 亦為探針或探測元件，故系爭專利請求項7 所附加之技術特徵揭示於證據8 。準此，證據8 、證據5 及證據7 之組合，足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

5. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項8不具進步性：

證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項8 依附於請求項1 ，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為複合互連元件。證據7 說明書第5 欄第32至37行「Furthermore, molybdenum (Mo), titanium (Ti), chrome (Cr), tantalum (Ta), niobium (Nb), copper (Cu)-beryllium (Be) group alloy and copper base material a surface of which is plated with a metal of harder quality than copper may be used as the material of the probes 」。揭示探針元件(14)可為表面披覆不同金屬之複合互連元件，故系爭專利請求項8 所揭之複合互連元件已揭示於證據7 。準此，系爭專利請求項8 為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 、證據5 及證據7 所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

6. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項9、12不具進步性：

證據8 及證據5 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項9 為依附於請求項1 ，其內容為依據請求項1之方法，其特徵在於焊料係連接在瓷塊基材與大基材之間。系爭專利請求項12依附於請求項1 ，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於瓷塊基材係藉焊料接頭而與大基材對準。證據5 雖揭示利用螺絲鎖固次基板與主機板，其與

系爭專利利用焊料進行基板間之黏著技術手段不同，惟證據7之第3圖揭示利用焊料(44)連接在面積較小之基板(40)與面積較大之多層佈線基板(43)間，且面積較小之基板可藉由焊料與面積較大之多層佈線基板對準，故系爭專利請求項9、12所揭之焊料黏著技術揭示於證據7。準此，系爭專利請求項9、12實為所屬技術領域具通常知識者，依證據8及證據5、證據7所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

7. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項10不具進步性：證據8及證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項10依附請求項1，其內容為依據請求項1之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件，係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片」。證據7之第4圖揭示探針(14)係以一對一為基礎接觸半導體晶圓(22)之個別半導體模片。準此，系爭專利請求項10為所屬技術領域具通常知識者，依證據8及證據5、證據7所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。
8. 組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項11不具進步性：證據8及證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項11依附於請求項1，其內容為依據請求項1之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件係接觸半導體晶片上之至少兩個半導體模片。證據7之第4圖揭示探針(14)係可接觸半導體晶圓(22)上之至少兩個半導體模片。準此，系爭專利請求項11為所屬技術領域具通常知識者依證據8及證據5、證據7所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。
9. 組合證據8、5及7可證系爭專利請求項13至14不具進步性：證據8及證據5之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性，系爭專利請求項13依附於請求項1，其內容為依據請求項1之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件。系爭專利請求項14，為依附於請求項1，其內容為依據請求項1之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件，並藉插入物連接至探測插件。證據8之圖5揭示插入物(504)及探測插件(502)，而證據5之圖1揭示瓷塊基材裝載至大基材。準此，系爭專利請求項13、14為所屬技術領域具通常知識者依證據8及證據5、證據7所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

(四)組合證據8、5及先前技術可證系爭專利請求項5至6不具進步性：

證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項5 依附請求項1 ，其內容為依據請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為印刷電路板。系爭專利請求項6 依附請求項1 ，其內容為依系爭專利請求項1 之方法，其特徵在於電子組件為液晶顯示板。證據8 之圖4 、5 、5B揭示一種探測半導體晶片(508) 方法，而半導體晶片、印刷電路板或液晶顯示板均為常見之待測電子組件，具通常知識者自可將探測半導體晶片之方法應用於探測印刷電路板或液晶顯示板，職是，系爭專利請求項5 、6 為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 、證據5 及公知技術所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

(五)組合證據8、5可證明系爭專利請求項16至18不具進步性：

1.組合證據8 、5 可證明系爭專利請求項16不具進步性：

證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項15不具進步性，系爭專利請求項16附於請求項15，其內容為依據系爭專利請求項15之探測插件組裝，其特徵在於探測元件為自由站立彈簧接點。證據8之圖4、5、5B已揭示回彈式互連元件(524)，可對應於系爭專利之自由站立彈簧接點，故系爭專利請求項15實為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 及證據5 所揭之技術內容所能輕易完成。職是，證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項16不具進步性。

2.組合證據8 、5 可證明系爭專利請求項17不具進步性：

證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項16不具進步性，系爭專利請求項17附於請求項16，其內容為依據系爭專利請求項16之探測插件組裝，其特徵在於尖端結構係經裝載至多個自由站立彈簧接點之末端。證據8 之圖4 、5 、5B 已揭示回彈式互連元件(524) ，可對應於系爭專利之自由站立彈簧接點，且回彈式互連元件具有尖端結構。另證據5 之第2 圖亦揭示探針3 具有尖端結構，故系爭專利請求項17實為所屬技術領域具通常知識者，依證據8 及證據5 所揭之技術內容所能輕易完成。職是，證據8 及證據5 之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

3.組合證據8 、5 可證明系爭專利請求項18不具進步性：

證據8 及證據5 之組合，足以證明系爭專利請求項16不具進步性，系爭專利請求項18依附於請求項16，其內容為依據系爭專利請求項16之探測插件組裝，其特徵在於自由站立彈簧接點為複合互連元件」。經查由系爭專利說明書所載發明背



景：在前述原始案中，揭示直接在電子組件上製造複合互連元件技術之內容可知。複合互連元件僅為一般通常知識，故系爭專利請求項18為所屬技術領域具通常知識者，依證據5及證據8所揭之技術內容所能輕易完成，故證據8及證據5之組合，足以證明系爭專利請求項18不具進步性。

#### 六、本判決結論：

綜上所述，系爭專利請求項1至14未違反修正前專利法第71條第3款規定；組合證據8與5，可證明系爭專利請求項1、15不具進步性；組合證據8、5及7可證明系爭專利請求項2至4、7至14不具進步性；組合證據8、5及先前技術可證明系爭專利請求項5、6不具進步性；組合證據8及5可證明系爭專利請求項16至18不具進步性。因被告所為舉發不成立處分，僅審查證據1至7與其等組合，未詳究其餘證據之組合，是否證明系爭專利具有進步性，致被告與本院就系爭專利是否應撤銷事由，容有不同見解。況原告嗣於本件訴訟中提出證據8之新證據與其等組合，亦導致被告無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，原告與參加人於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分。職是，原處分為舉發不成立之處分，雖有未洽，訴願機關為駁回之決定，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。故原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然為兼顧參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具進步性之程序利益，本院自不得逕為舉發成立而撤銷全部專利權之判決，故原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第200條第4款、第104條、第218條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 12 月 19 日  
智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行  
法 官 熊誦梅  
法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中華民國 102 年 12 月 19 日  
書記官 吳羚榛

附圖與附表：